

МАЛОГАБАРИТНАЯ ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА ТРАВЛЕНИЯ СЛОЕВ МЕТОДОМ РЕАКТИВНО-ИОННОГО ТРАВЛЕНИЯ

МВУ ТМ ПЛАЗМА 01

Назначение: Травление тонких диэлектрических и металлических слоёв, а также полупроводниковых материалов методом реактивно – ионного травления.



Особенности:

- Индивидуальная обработка подложек в одном технологическом цикле: до \varnothing 150 мм – 1 шт.;
- Измерение ВЧ смещения на ВЧ электроде – подложкодержателе в диапазоне от 0 до 1000 В;
- Регулирование и автоматическое поддержание уровня мощности ВЧ в диапазоне 30 – 200 Вт;
- Рабочие газы: Ar, SF₆, O₂, CF₄;
- Безмасляная система откачки;
- Микропроцессорная система управления;
- Мощность потребления не более 4 кВт.

